



Europäisches Patentamt

(19)

European Patent Office

Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

**0 119 424**

B1

(12)

**EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**(45) Veröffentlichungstag der Patentschrift :  
06.05.87(51) Int. Cl.<sup>1</sup> : **C 25 D 3/62**

(21) Anmeldenummer : 84101158.8

(22) Anmeldetag : 04.02.84

(54) Verfahren zum Abscheiden von niederkarätigen, glänzenden Gold-Silber-Legierungsüberzügen.

(30) Priorität : 16.03.83 DE 3309397

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung :  
26.09.84 Patentblatt 84/39

(45) Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung : 06.05.87 Patentblatt 87/19

(84) Benannte Vertragsstaaten :  
AT BE CH DE FR GB IT LI NL

(56) Entgegenhaltungen :

DE-C- 750 185

DE-C- 1 213 196

US-A- 3 475 292

US-A- 3 864 222

US-A- 4 121 982

CHEMICAL ABSTRACTS, Band 73, Nr. 14, 5. Oktober  
1970, Seite 444, Nr. 72575w, Columbus, Ohio, USADie Akte enthält technische Angaben, die nach dem  
Eingang der Anmeldung eingereicht wurden und die  
nicht in dieser Patentschrift enthalten sind.(73) Patentinhaber : Degussa Aktiengesellschaft  
Weisfrauenstrasse 9  
D-6000 Frankfurt am Main 1 (DE)(72) Erfinder : Dorbath, Bernd, Dr. Dipl.-Chem.  
Fürstenbergstrasse 4  
D-6450 Hanau 9 (DE)  
Erfinder : Schlodder, Rainer, Dr. Dipl.-Chem.  
Ulmenstrasse 63  
D-6458 Rodenbach 1 (DE)  
Erfinder : Giesecke, Norbert  
Feldbergstrasse 18  
D-6454 Bruchköbel (DE)**EP 0 119 424 B1**

Anmerkung : Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingereicht, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abscheiden von niederkarätigen, glänzenden, in weiten Arbeitsbereichen zusammensetzungsstabilen Legierungen.

galvanische Abscheidung von Gold-Silber-Legierungsüberzügen ist schon viele Jahre bekannt. Bei Stromdichten von 0,1 bis 1 A/dm<sup>2</sup> können dabei Legierungsschichten mit Gehalten von 29 bis 79 % Gold abgeschieden werden. Mit abnehmendem Goldgehalt und zunehmender Schichtdicke wächst jedoch die Sprödigkeit der Überzugschicht. Außerdem sind diese Überzüge wenig glänzend.

Durch Zusatz von organischen Substanzen und/oder Fremelmetallen, die nicht mitabgeschieden werden, zum Elektrolyten lassen sich glänzende Überzüge abscheiden. Bekannt sind beispielsweise Verbindungen von Nickel, Antimon, Titan und Indium als Glanzzusätze bei elektrolytischen Gold-Silber-Bädern. Bekannt als organische Glanzbildner sind z. B. Triphenylmethanfarbstoffe (DD-PS 98 698), Kondensationsprodukte aus Polyalkyleniminen und Alkylenpolyaminen (DE-PS 27 13 507). In der CH-PS 629 260 wird als Glanzzusatz eine wasserlösliche Indiumverbindung zusammen mit einem organischen aliphatischen Amin beschrieben, in der US-PS 4 121 982 die Kombination einer selenhaltigen Verbindung mit einem Polyäthylenamin und in der DE-PS 12 13 196 die Kombination einer selenhaltigen Verbindung und eines mit Aminoalkoholen stabilisierten Titanesters. Alle diese bekannten Glanzzusätze haben jedoch den Nachteil, daß ein befriedigender Glanz nur bis Schichtdicken von ca. 25 µm erhalten werden kann und gegebenenfalls organische Substanzen in die Schicht eingebaut werden. Die Sprödigkeit der Überzüge können sie nicht vermindern.

Bei den bekannten Gold-Silber-Legierungsbädern ist der Goldgehalt im Überzug weitgehend abhängig von Au/Ag-Verhältnis im Bad und von den gewählten Betriebsparametern bei der Abscheidung, insbesondere von der Stromdichte und der Badtemperatur. Diese Abhängigkeiten sind nachteilig für einen praktischen Badbetrieb zur Abscheidung niederkarätiger Gold-Silberlegierungen mit einem gleichbleibendem Karatgehalt.

Es war daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum Abscheiden von niederkarätigen, glänzenden, in weiten Arbeitsbereichen zusammensetzungsstabilen Gold-Silber-Legierungen zu entwickeln, bei dem gleichbleibend niederkarätige Schichten weitgehend unabhängig von den Betriebsparametern, wie Stromdichte und Badtemperatur, erhalten werden, und bei dem auch Schichtdicken über 25 µm glänzend und möglichst duktil abgeschieden werden können.

Diese Aufgabe wurde erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß ein elektrolytisches Bad, bestehend aus einer wässrigen Lösung von 0,5 bis

25 g/l Gold in Form von Alkaligoldzyanid, 0,25 bis 15 g/l Silber in Form von Alkalisisberzyanid und 10 bis 200 g/l Alkalizyanid und zusätzlich 0,000 5 bis 5 g/l Tellur in Form einer wasserlöslichen Tellurverbindung und eventuell einem Netzmittel verwendet wird.

Vorzugsweise enthält der Elektrolyt 0,001 bis 1 g/l Tellur in Form einer wasserlöslichen Tellurverbindung, wobei das Tellur in der Oxydationsstufe II, IV oder VI vorliegen kann. Beispiele für solche tellurhaltigen Badzusätze sind das Tellurdioxid (TeO<sub>2</sub>), das Tellurtrioxid (TeO<sub>3</sub>), die tellurige Säure und ihre Derivate, wie Tellurite und höherkondensierte molekulare Komplexe, die Tellursäure und ihre Derivate, Tellur-Halogen-Verbindungen und Telluride. Am besten bewährt hat sich die Anwesenheit von Telluriten und/oder Tellurataten im Bad.

Bereits bei Anwesenheit von geringen Mengen der wasserlöslichen Tellurverbindungen im Bad erhält man glänzende, niederkarätige Gold-Silber-Legierungsüberzüge, ohne sonstige organische oder anorganische Verbindungen zur Glanzbildung zusetzen zu müssen. Die Überzüge enthalten kein nachweisbares Tellur.

Man erhält bei dem erfindungsgemäßen Verfahren hervorragend glänzende, brillante Gold-Silber-Legierungsüberzüge, die sich nicht nur durch ihren Glanz auszeichnen, sondern auch durch ihre relativ geringe Anlaufempfindlichkeit und ihre Duktilität.

Außerdem wird durch den Tellurzusatz die bekannte deutliche Abhängigkeit der Legierungszusammensetzung in den niederkarätigen Au/Ag-Legierungsschichten von den Arbeitsparametern des Bades, wie Stromdichte, Badtemperatur und Metallgehalte, erheblich abgeschwächt. Mit einem solchen Bad erhält man in wesentlich breiteren Arbeitsbereichen eine gleichmäßige Legierungszusammensetzung.

Dieser Effekt ist vor allem für die praktische Anwendung des Bades von besonderem Vorteil.

Beispielsweise erzielt man im Stromdichtebereich von 0,6-1,2 A/dm<sup>2</sup> eine auf ein Karat genaue, 12-karätige, glänzende Gold-Silber-Legierungsabscheidung. Auch praxisnahe Abweichungen anderer Arbeitsparameter, wie Temperatur, pH-Wert, Gold-, Silber-, und KCN-Gehalt, von den festgelegten Badbetriebswerten verändern die Zusammensetzung und Qualität der abgeschiedenen Legierungen kaum. Zum Beispiel können sich bei der Abscheidung einer niederkarätigen Gold-Silber-Legierung bei einer Stromdichte von ca. 0,9 A/dm<sup>2</sup>, einer Badtemperatur von 40 °C und einem pH-Wert von 11,5 die Badtemperatur um ± 5 °C oder der pH-Wert zwischen 10,5 und 12,5 ändern, ohne daß die Zusammensetzung der abgeschiedenen 12-karätigen Legierung um mehr als ± 1 Karat schwankt.

Auch für den Gehalt an freiem KCN und KAg(CH)<sub>2</sub> sind relativ große Konzentrationsschwankungen möglich, ohne daß sich Zu-

sammensetzung und Qualität der niederkarätigen Gold-Silber-Überzüge wesentlich verändern. Dabei sollte aber das Verhältnis Gold zu Silber einen Wert von 4 : 1 möglichst nicht überschreiten und einen Wert von 1 : 2 möglichst nicht unterschreiten.

Außerdem erlauben es diese Bäder, daß niederkarätige, glänzende Gold-Silber-Legierungsichten mit Schichtdicken über 100 µm in einzigen Abscheidevorgang ohne Zwischenbehandlung erzeugt werden können. Auch die ca. 100 µm dicken, niederkarätigen Gold-Silber-Legierungsschichten zeigen noch einen hervorragenden Glanz und eine auffallend gleichbleibende Legierungszusammensetzung über die gesamte Schichtdicke. Daher eignen sich solche Gold-Silber-Legierungsbäder auch für die galvanoplastische Erzeugung von 12-14-karätigen Gold-Silber-Formteilen.

Üblicherweise verwendet man einen bekannten Elektrolyten, der in einer wässrigen Lösung Gold, Silber und freies Kaliumzyanid gelöst enthält, und setzt ihm eine tellurhaltige Verbindung zu, die entweder in Wasser löslich ist oder sich mit Wasser zu einer löslichen Verbindung umsetzt. Vorzugsweise wird das Bad mit Kaliumsalzen angesetzt, jedoch können auch Natriumsalze oder Ammoniumsalze verwendet werden, bzw. sonstige Umsetzungsprodukte von AuCN und AgCN mit Alkalizyaniden. Bewährt haben sich Bäder, die 5 bis 10 g/l Gold in Form von Kalium-Goldzyanid, 1 bis 6 g/l Silber in Form von Kaliumsilberzyanid und 50 bis 150 g/l Kaliumzyanid enthalten.

Unterschiedliche tellurhaltige Verbindungen erfordern zur Erzielung des gleichen Effektes unterschiedliche Konzentrationen. Beispielsweise reichen beim Zusatz von K<sub>2</sub>TeO<sub>3</sub> bereits 5-30 mg/l für eine gleichmäßige Abscheidung einer niederkarätigen Gold-Silber-Legierungsabscheidung. Bei Verwendung von Tellursäure muß man zum Erreichen des gleichen Effektes hingegen im Grammbereich, bezogen auf die Tellursäure, arbeiten. Der Tellurgehalt des Bades läßt sich dabei analytisch leicht überwachen.

Durch Zusatz von Benetzungsmittern, wie z. B. teilveresterter Formen der Phosphorsäure, kann die Qualität der Überzüge verbessert werden. Vorzugsweise verwendet man solche Netzmittel im Konzentrationsbereich von 0.5-5 ml/l.

Das Bad wird auf einen alkalischen pH-Wert gehalten, vorzugsweise zwischen 10,5 und 12,5. Die geeignete Badtemperatur liegen zwischen 25 °C und 70 °C. Je höher die Badtemperatur, desto höher liegt auch die für die Abscheidung qualitativ einwandfreier niederkarätiger Au/Ag-Legierungen notwendige Stromdichte.

Beispielsweise erhält man bei einer Badtemperatur von 40 °C in einem Stromdichtebereich von 0,6 bis 1,2 A/dm<sup>2</sup> eine Gold-Silber-Legierung von 12 Karat ± 1 Karat. Bei einer Badtemperatur von 70 °C erhält man die gleiche Legierungszusammensetzung in einem Stromdichtebereich von 2,2 bis 3,0 A/dm<sup>2</sup>.

Folgende Beispiele sollen das erfindungsgemäße Verfahren näher charakterisieren:

1. Aus einem wässrigen Elektrolyten, der 9 g/l KAu(CN)<sub>2</sub>, 4,5 g/l KAg(CN)<sub>2</sub>, 1 ml/l Netzmittel und 80 g/l KCN gelöst enthält, kann man bei 40 °C und pH 11 im Stromdichtebereich von 0,6 bis 1,0 gründlich-gelbe, matte ca. 18-karätige Gold-Silber-Legierungsüberzüge abscheiden. Gibt man diesem Bad 20 mg/l K<sub>2</sub>TeO<sub>3</sub>, zu, so erhält man unter den gleichen Bedingungen in einem Stromdichtebereich von 0,6 bis 1,2 A/dm<sup>2</sup> glänzende, gelblich weiße, ca. 12-karätige Gold-Silber-Legierungsüberzüge.
2. Ein wässriger Elektrolyt enthält 3 g/l KAu(CN)<sub>2</sub>, 1 g/l KAg(CN)<sub>2</sub>, 20 g/l freies KCN, 0,05 ml/l Netzmittel und 2 g/l Tellursäure. Bei einem pH-Wert von 11 und einer Badtemperatur von 40 °C erhält man bei 0,6 ; 0,8 ; 1,0 A/dm<sup>2</sup> glänzende ca. 12-14-karätige Gold-Silber-Legierungsabscheidungen.
3. Ein wässriger Elektrolyt enthält 10 g/l KAg(CN)<sub>2</sub>, 15 g/l KAu(CN)<sub>2</sub>, 200 g/l freies KCN und 5 ml/l Netzmittel. Nach Zugabe von 4 g/l TeCl<sub>4</sub> lassen sich zwischen 2,2 und 3,0 A/dm<sup>2</sup> bei pH 11 und einer Badtemperatur von 70 °C glänzende, 10-14-karätige Gold-Silber-Legierungen erzeugen.
4. Aus einem Elektrolyten gemäß Beispiel 1 kann man bei einer Stromdichte von 1,0 A/dm<sup>2</sup> auf ein 1 × 2 cm großes, poliertes und vernickeltes Messingblech eine 12-karätige, glänzende, 100 µm dicke Gold-Silber-Legierungsschicht abscheiden. Bei einem pH-Wert von 11 und einer Badtemperatur von 40 °C wird die 100 µm dicke Au/Ag-Schicht ohne Zwischenbehandlung glänzend erhalten.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zum Abscheiden von niederkarätigen, glänzenden, in weiten Arbeitsbereichen zusammensetzungsstabilen Gold-Silber-Legierungen, dadurch gekennzeichnet, daß ein elektrolytisches Bad, bestehend aus einer wässrigen Lösung von 0,5 bis 25 g/l Gold in Form von Alkaligoldzyanid, 0,25 bis 15 g/l Silber in Form von Alkalisolberzyanid und 10 bis 200 g/l Alkalizyanid und zusätzlich 0,0005 bis 5 g/l Tellur in Form einer wasserlöslichen Tellurverbindung und eventuell einem Netzmittel verwendet wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Bad 0,001 bis 1 g/l Tellur in Form einer wasserlöslichen Tellurverbindung enthält.
3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Bad das Tellur in Form von Tellurit und/oder Tellurat enthält.
4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Bad teilveresterte Phosphorsäuren als Netzmittel enthält.

#### Claims

1. A process for the deposition of low-carat,

lustrous gold-silver alloys which are stable in composition in wide spheres of operation, characterised in that an electrolytic bath composed of an aqueous solution of from 0.5 to 25 g/l of gold in the form of alkali gold cyanide, from 0.25 to 15 g/l of silver in the form of alkali silver cyanide and from 10 to 200 g/l of alkali cyanide and also 0.0005 to 5 g/l of tellurium in the form of a water-soluble tellurium compound and optionally a wetting agent is used.

2. A process according to claim 1, characterised in that the bath contains from 0.001 to 1 g/l of tellurium in the form of a water-soluble tellurium compound.

3. A process according to claim 1 and 2, characterised in that the bath contains the tellurium in the form of tellurite and/or tellurate.

4. A process according to claims 1 to 3, characterised in that the bath contains partially esterified phosphoric acids as wetting agent.

### Revendications

5

1. Procédé pour déposer des alliages or/argent à faible nombre de carats, brillants, dont la composition soit stable dans de larges champs d'opération, caractérisé en ce que l'on utilise un bain électrolytique, constitué d'une solution aqueuse de 0,5 à 25 g/l d'or, sous la forme de cyanure d'or alcalin, 0,25 à 15 g/l d'argent, sous la forme de cyanure d'argent alcalin, et 10 à 200 g/l de cyanure alcalin, et supplémentairement 0,0005 à 5 g/l de tellure sous la forme d'un composé du tellure soluble à l'eau, et éventuellement d'un agent mouillant.

10

2. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le bain contient 0,001 à 1 g/l de tellure, sous la forme d'un composé de tellure soluble à l'eau.

15

3. Procédé suivant l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le bain contient le tellure sous la forme de tellurite et/ou de tellurate.

20

4. Procédé suivant l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le bain contient, comme agent mouillant de l'acide phosphorique partiellement estérifié.

25

30

35

40

45

50

55

60

65

REGISTER ENTRY FOR EP0119424

European Application No EP84101158.8 filing date 04.02.1984

Application in German

Priority claimed:

16.03.1983 in Federal Republic of Germany - doc: 3309397

Designated States BE CH DE FR GB IT LI NL AT

Title

Applicant/Proprietor

DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, Weissfrauenstrasse 9, D-6000 Frankfurt am Main  
1, Federal Republic of Germany [ADP No. 50480391002]

Inventors

DR. DIPL.-CHEM. BERND DORBATH, Fürstenbergstrasse 4, D-6450 Hanau 9,  
Federal Republic of Germany [ADP No. 52949658001]

DR. DIPL.-CHEM. RAINER SCHLODDER, Ulmenstrasse 63, D-6458 Rodenbach 1,  
Federal Republic of Germany [ADP No. 52949666001]

NORBERT GIESECKE, Feldbergstrasse 18, D-6454 Bruchköbel, Federal Republic  
of Germany [ADP No. 52949674001]

Classified to

C7B

C25D

Address for Service

ELKINGTON AND FIFE, High Holborn House, 52/54 High Holborn, London, WC1V  
6SH, United Kingdom [ADP No. 00000067001]

Publication No EP0119424 dated 26.09.1984 and granted by EPO 06.05.1987.

Publication in German

Examination requested 04.02.1984

Patent Granted with effect from 06.05.1987 (Section 25(1)) with title PROCESS  
FOR THE DEPOSITION OF LOW CARAT BRILLIANT GOLD-SILVER ALLOY COATINGS

---

\*\*\*\* END OF REGISTER ENTRY \*\*\*\*

DA80-01  
FG

OPTICS - PATENTS

17/05/91 11:48:56  
PAGE: 1

RENEWAL DETAILS

PUBLICATION NUMBER EP0119424

PROPRIETOR(S)

Degussa Aktiengesellschaft, Weissfrauenstrasse 9, W-6000 Frankfurt  
am Main 1, Federal Republic of Germany

DATE GRANTED 06.05.1987

DATE NEXT RENEWAL DUE 04.02.1992

DATE NOT IN FORCE

DATE OF LAST RENEWAL 25.01.1991

YEAR OF LAST RENEWAL 08

STATUS PATENT IN FORCE

IN THE MATTER OF European Patent

No. 0 119 424

in the name of

Degussa Aktiengesellschaft

and

IN THE MATTER OF a Patent

Application in Hong Kong

I, MARIA ANTONIA JOSEFA RYDER, translator,  
of 40, Compton Road, London N1 2PB, England,  
do solemnly and sincerely declare as follows:

1. That I am well acquainted with the English and German languages
2. That the following is a true translation made by me of European Patent Specification

No. 0 119 424 B1

AND I MAKE this Solemn Declaration conscientiously believing the same to be true and by virtue of the provisions of the Statutory Declarations Act 1835

DECLARED AT 3, Albemarle Street,  
London W1X 3HF, England  
THIS 3rd day of October

1991 )

MAR Ryder

BEFORE ME:

A. N. ROBINSON

A. N. ROBINSON  
Notary Public of London, England



(12)

## EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Publication date of

Patent specification: 06.05.87

(21) Application No. 84101158.8

(22) Application date: 04.02.84(51) Int.Cl<sup>4</sup>: C 25 D 3/62

---

(54) Process for the deposition of low carat brilliant gold-silver alloy coatings

---

(30) Priority: 16.03.83 DE 3309397

(73) Patentee:  
Degussa Aktiengesellschaft  
Weissfrauenstrasse 9  
D-6000 Frankfurt am Main 1 (DE)(43) Publication date of Application:  
26.09.84 Patentblatt 84/39(45) Publication of notification  
of Patent grant: 06.05.87 Patentblatt 87/19

72) Inventor: Dorbath, Bernd, Dr. Dipl.-Chem  
Fürstenbergstrasse 4  
D-6450 Hanau 9 (DE)  
Inventor: Schlodder, Rainer, Dr. Dipl.-Chem  
Ulmenstrasse 63  
D-6458 Rodenbach 1 (DE)  
Inventor: Giesecke Norbert  
Feldbergstrasse 18  
D-6454 Bruchköbel (DE)

(84) Designated Treaty States:  
AT BE CH DE FR GB IT LI NL

(56) Citations:

DE-C-750 185; DE-C-1 213 196;

US-A-3 475 292; US-A-3 864 222; US-A-4 121 982

CHEMICAL ABSTRACTS, Vol. 73, No. 14, 5th October 1970, page 444,  
No. 72575w, Columbus, Ohio, USA.The file contains technical details which were filed after the  
Application was received and are not contained in this Patent  
Specification.

---

Note: Within nine months after publication of the notification of grant of the European Patent in the European Patent Journal, any person can file opposition at the European Patent Office against the granted European Patent. The opposition must be filed in writing with Grounds. It is validly filed only when the Opposition fee has been paid. (Art.99(1) of European Patent Agreement).

---

Jouve, 18, rue St.-Denis, 75001 Paris,

**Description**

This invention relates to a process for the deposition of low carat, brilliant alloys which are stable in their composition over wide operating ranges.

5       The galvanic deposition of coatings of gold-silver alloys has been known for many years. Layers of alloys containing from 29 to 79% of gold can be deposited at current densities of from 0.1 to 1 A/dm<sup>2</sup> but the brittleness of the coating layer increases with decreasing gold  
10 content and increasing thickness of the layer. Moreover, these coatings have little lustre.

Brilliant coatings can be deposited by adding to the electrolyte organic substances and/or foreign metals which are not deposited at the same time. It is known, for  
15 example, to use compounds of nickel, antimony, titanium and indium as lustering additives to electrolytic gold-silver baths. Known organic lustering agents are, for example, triphenylmethane dyes (DD-PS 98 698) and condensation products of polyalkylene imines and alkylene  
20 polyamines (DE-PS 27 13 507). A water-soluble indium compound used together with an organic aliphatic amine is described as lustering additive in CH-PS 629 260; the combination of a selenium-containing compound and a polyethylene amine is described in US-PS 4 121 982 and the  
25 combination of a selenium-containing compound and a titanium ester which has been stabilized with amino alcohols is described in DE-PS 12 13 196. All these known lustering additives have, however, the disadvantage that a satisfactory lustre can only be obtained with layers  
30 thicknesses of up to about 25 µm and organic substances are liable to be incorporated in the layer. They are unable to reduce the brittleness of the coatings.

In the known gold-silver alloying baths, the gold

content in the coating depends to a large extent on the Au/Ag ratio in the bath and on the selected operating parameters for the deposition, in particular on the current density and the bath temperature. These dependences are a disadvantage for the practical operation of a bath for the deposition of low carat gold-silver alloys which are to have a constant carat content.

It was therefore an object of the present invention to develop a process for the deposition of low carat, brilliant gold-silver alloys which are stable in their composition over a wide operating range, in which consistently low carat layers are obtained substantially independently of the operating parameters such as the current density and bath temperature and in which layers deposited in a thickness above 25  $\mu\text{m}$  can also be obtained with good lustre and ductility.

This problem was solved according to the invention by using an electrolytic bath consisting of an aqueous solution of from 0.5 to 25 g/l of gold in the form of alkali gold cyanide, from 0.25 to 15 g/l of silver in the form of alkali silver cyanide and from 10 to 200 g/l of alkali cyanide and, in addition, from 0.0005 to 5 g/l of tellurium in the form of a water-soluble tellurium compound and possibly a wetting agent.

The electrolyte preferably contains from 0.001 to 1 g/l of tellurium in the form of a water-soluble tellurium compound in which the tellurium may be present in oxidation stage II, IV or VI. Examples of such tellurium-containing bath additives include tellurium dioxide ( $\text{TeO}_2$ ), tellurium trioxide ( $\text{TeO}_3$ ), tellurous acid and its derivatives such as tellurites and relatively highly condensed molecular complexes, telluric acid and its derivatives, tellurium-halogen compounds and tellurides. The presence of tellurides and/or tellurates

in the bath has proved to be the most useful.

The presence of even small quantities of water-soluble tellurium compounds in the bath results in lustrous, low carat coatings of gold-silver alloys without 5 requiring the addition of other organic or inorganic compounds for producing the lustre. The coatings contain no detectable tellurium.

Brilliant coatings of gold-silver alloys with an outstanding lustre are obtained by the process according 10 to the invention; these coatings are distinguished not only by their lustre but also by their relatively low tendency to tarnish and their ductility.

Further, the addition of tellurium considerably attenuates the well known dependence of the composition of 15 the alloys in the layers of low carat Au/Ag alloys on the operating parameters of the bath, such as the current density, the bath temperature and the metal contents.

A uniform composition of alloys is obtained with such a bath over substantially wider operating ranges.

20 This effect is particularly advantageous for the use of the bath in practice.

For example, a 12-carat, lustrous gold-silver alloy deposition is obtained to an accuracy of one carat in the current density range of from 0.6 to 1.2 A/dm<sup>2</sup>. Even when 25 other operating parameters, such as temperature, pH and gold, silver and KCN content differ from the values laid down for the operation of the bath within the normal margins of error encountered in practice, hardly any change occurs in the composition and quality of the 30 deposited alloys. For example, when a low carat gold-silver alloy is deposited at a current density of about 0.9 A/dm<sup>2</sup>, a bath temperature of 40°C and a pH of 11.5, the bath temperature may vary by ±5°C or the pH may vary within the range of from 10.5 to 12.5 without the

composition of the deposited 12 carat alloy fluctuating by more than  $\pm 1$  carat.

The free KCN content and KAg(CH)<sub>2</sub> content may also vary within relatively wide ranges of concentration  
5 without the composition and quality of the low carat gold-silver coatings being subject to any significant change. The ratio of gold to silver should, however, as far as possible not exceed a value of 4:1 or fall below a value of 1:2.

10 Furthermore, these baths enable layers of low carat, lustrous gold-silver alloys with thicknesses above 100  $\mu\text{m}$  to be produced in a single deposition process without intermediate treatment. The layers of low carat gold-silver alloys about 100  $\mu\text{m}$  in thickness still have  
15 excellent lustre and an outstandingly constant composition of the alloy throughout the whole thickness of the layer. Such gold-silver alloy baths are therefore also suitable for the galvanoplastic production of 12-14 carat gold-silver mouldings.

20 A known electrolyte is normally used, containing gold, silver and free potassium cyanide dissolved in an aqueous solution, and a tellurium-containing compound which is either soluble in water or reacts with water to form a soluble compound is added to this electrolyte. The  
25 bath is preferably prepared with potassium salts but sodium salts or ammonium salts or other reaction products of AuCN and AgCN with alkali metal cyanides may also be used. Baths containing from 5 to 10 g/l of gold in the form of potassium gold cyanide, from 1 to 6 g/l of silver  
30 in the form of potassium silver cyanide and from 50 to 150 g/l of potassium cyanide have proved to be satisfactory.

Different tellurium-containing compounds require different concentrations for producing the same effect. For example, when K<sub>2</sub>TeO<sub>3</sub> is used, the addition of only

5-30 mg/l is sufficient for a uniform deposition of a low carat gold-silver alloy. When telluric acid is used, on the other hand, quantities in the range of grammes, based on the telluric acid, are required for achieving the same 5 effect. The tellurium content of the bath can easily be monitored analytically.

The quality of the coatings may be improved by the addition of wetting agents, e.g. partially esterified forms of phosphoric acid. Such wetting agents are 10 preferably used in the concentration range of from 0.5 to 5 ml/l.

The bath is maintained at an alkaline pH, preferably at a pH of from 10.5 to 12.5. The suitable bath temperatures lie from 25°C to 70°C. The higher the bath 15 temperature, the higher is also the current density required for the deposition of qualitatively perfect low carat Au/Ag alloys.

At a bath temperature of 40°C, for example, a gold-silver alloy of 12-carat 11 carat is obtained in a current 20 density range of from 0.6 to 1.2 A/dm<sup>2</sup>. At a bath temperature of 70°C, the same composition of alloy is obtained in a current density range of from 2.2 to 3.0 A/dm<sup>2</sup>.

The following Examples serve to characterise the 25 process according to the invention in more detail:

1. Greenish yellow, matt, approximately 18-carat gold-silver alloy coatings can be deposited from an aqueous electrolyte containing 9 g/l of KAu(CN)<sub>2</sub>, 4.5 g/l of KAg(CN)<sub>2</sub>, 1 ml/l of wetting agent and 80 g/l of KCN in 30 solution at 40°C and pH 11 in the current density range of from 0.6 to 1.0. When 20 mg/l of K<sub>2</sub>TeO<sub>3</sub> are added to this bath, lustrous, yellowish white, approximately 12-carat gold-silver alloy coatings are obtained under the same conditions in a current density range of from 0.6 to 1.2

A/dm<sup>2</sup>.

2. An aqueous electrolyte contains 3 g/l of  $\text{KAu}(\text{CN})_2$ , 1 g/l of  $\text{KAg}(\text{CN})_2$ , 20 g/l of free KCN, 0.05 ml/l of wetting agent and 2 g/l of telluric acid. At a pH of 11 and a bath temperature of 40°C, lustrous, approximately 12-14-carat gold-silver alloy depositions are obtained at 0.6; 0.8; and 1.0 A/dm<sup>2</sup>.

3. An aqueous electrolyte contains 10 g/l of  $\text{KAg}(\text{CN})_2$ , 15 g/l of  $\text{KAu}(\text{CN})_2$ , 200 g/l of free KCN and 5 ml/l of wetting agent. After the addition of 4 g/l of  $\text{TeCl}_4$ , lustrous, 10-14-carat gold-silver alloys can be produced at from 2.2 to 3.0 A/dm<sup>2</sup> and at pH 11 and a bath temperature of 70°C.

4. A 12-carat, lustrous layer of gold-silver alloy 100 μm in thickness can be deposited on a polished and nickel-plated sheet of brass measuring 1 x 2 cm from an electrolyte according to Example 1 at a current density of 1.0 A/dm<sup>2</sup>. At a pH of 11 and a bath temperature of 40°C, the Au/Ag layer 100 μm in thickness is obtained as a lustrous layer without intermediate treatment.

#### Patent Claims

1. A process for the deposition of low carat lustrous gold-silver alloys which are stable in composition over wide spheres of operation, characterised in that an electrolytic bath composed of an aqueous solution of from 0.5 to 25 g/l of gold in the form of alkali gold cyanide, from 0.25 to 15 g/l of silver in the form of alkali silver cyanide and from 10 to 200 g/l of alkali cyanide and also 0.0005 to 5 g/l of tellurium in the form of a water-soluble tellurium compound and optionally a wetting agent is used.

2. A process according to Claim 1, characterised in

0 119 424

that the bath contains from 0.001 to 1 g/l of tellurium in the form of a water-soluble tellurium compound.

3. A process according to Claims 1 and 2, characterised in that the bath contains the tellurium in the  
5 form of tellurite and/or tellurate.

4. A process according to Claims 1 to 3, characterised in that the bath contains partially esterified phosphoric acids as wetting agent.